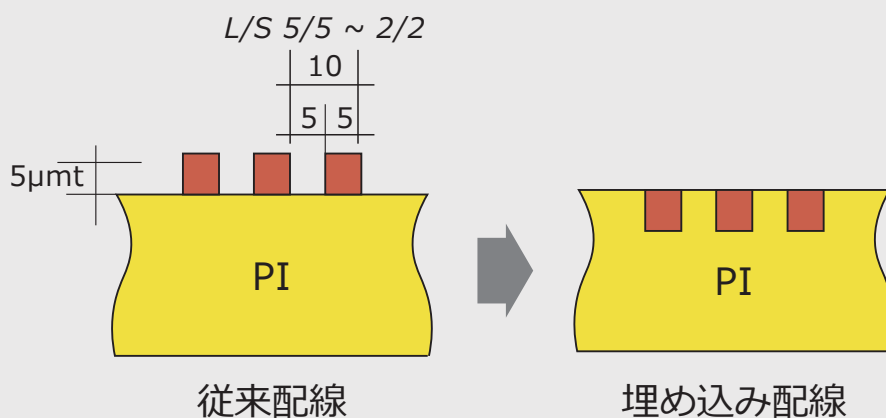
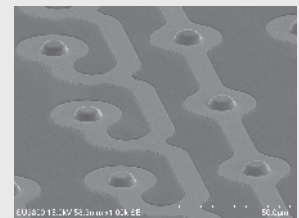
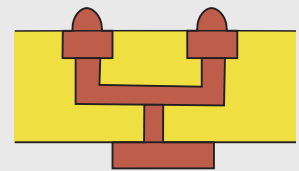


キャストニング工法とセミアディティブ銅めつき法を用いることにより、任意の厚みに塗布したPI樹脂上に埋め込み型の厚膜電極を形成。その加工を繰り返すことで、多層電極基板を製作することが可能です。

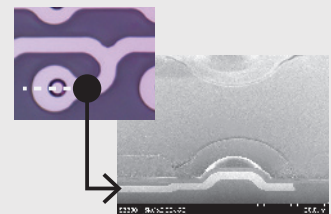
## 埋め込み電極で、細線甲高配線の密着



## 多層配線構造



バンプ付配線



断面形状

## せん断 剪断応力バツグンの威力

### 細線 L / S

